

<<电子技术工艺基础>>

图书基本信息

书名：<<电子技术工艺基础>>

13位ISBN编号：9787302039471

10位ISBN编号：730203947X

出版时间：2000-1

出版时间：清华大学出版社

作者：王天曦，李鸿儒 编著

页数：288

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子技术工艺基础>>

内容概要

《高等学校教材：电子技术工艺基础》以电子技术基本工艺知识和电子装配技术为主，对电子产品制造过程及典型工艺作了全面介绍，包括安全用电、焊接技术、电子元器件、印制电路板、装配与连接技术、表面安装技术、调试与检测技术、电子技术文件等内容，是一本很有实用价值的教科书。

作者有二十余年电子技术工作经验，经历了十二年电子工艺实习教学实践编写本教材历时三年，经数次修改，使《高等学校教材：电子技术工艺基础》内容充实、详略得当、可读性强，信息量大；兼有实用性、资料性和先进性，书中涵有大量来自生产实践的经验。

《高等学校教材：电子技术工艺基础》文字流畅，插图丰富、精美，直观效果很好，与同类书比，《高等学校教材：电子技术工艺基础》确有独到之处。

《高等学校教材：电子技术工艺基础》可作为各类理工科学生参加电子工艺实习的教材，亦可作为电子科技创新实践课程设计，毕业实践等活动的实用指导书，同时也可供职业教育、技术培训及有关技术人员参考。

<<电子技术工艺基础>>

书籍目录

第1章 安全用电1.1 人身安全1.2 设备安全1.3 电气火灾1.4 用电安全技术简介1.5 电子装接操作安全1.6 触电急救与电气消防第2章 焊接技术2.1 焊接技术与锡焊2.2 锡焊机理2.3 锡焊工具与材料2.4 手工锡焊基本操作2.5 手工锡焊技术要点2.6 实用锡焊技艺2.7 焊接质量及缺陷2.8 工业生产锡焊技术第3章 电子元器件3.1 电抗元件3.2 机电元件3.3 半导体分立器件3.4 集成电路3.5 电子元器件选用3.6 电子元器件检测与筛选第4章 印制电路板4.1 印制电路板及互连4.2 印制电路板设计基础4.3 印制板设计技巧4.4 印制板设计过程与方法4.5 印制板制造与检验4.6 印制电路板CAD简介4.7 印制电路板新发展第5章 装配与连接5.1 安装技术5.2 导线配置5.3 其他连接方法第6章 表面安装与微组装技术6.1 安装技术与表面安装6.2 表面安装元器件6.3 表面安装技术简介6.4 微组装技术第7章 调试与检测7.1 调试与检测基础7.2 调试与检测安全7.3 调试技术7.4 故障检测方法第8章 电子技术文件8.1 电子技术文件概述8.2 产品技术文件8.3 图形符号及说明8.4 原理图简介8.5 工艺图简介8.6 电子技术文件计算机处理系统简介附录1 电气图形符号国家标准附录2 国内外部分电气图形符号对照附录3 电气图形常用文字符号参考文献

<<电子技术工艺基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>